



中华人民共和国国家标准

GB 7509—87

半导体集成电路微处理器 空白详细规范

Blank detail specification for microprocessor
semiconductor integrated circuits

(可供认证用)

1987-03-25发布

1987-11-01试行

国家标准局 发布

中华人民共和国国家标准

半导体集成电路微处理器 空白详细规范

UDC 621.38
.049.774
GB 7509—87

Blank detail specification for microprocessor
semiconductor integrated circuits
(可供认证用)

本规范规定了编制半导体集成电路微处理器（以下简称器件）详细规范的基本原则。
本规范是与GB 4589.1—84《半导体集成电路总规范》有关的一系列空白详细规范之一。

要求的资料

下列①~⑨项要求的内容与首页表中各栏资料相对应，编制详细规范时应填写在相应的栏中。

详细规范的识别

- ① 发布详细规范的国家标准化机构名称。
- ② IECQ详细规范的编号。
- ③ 总规范号和年代号。
- ④ 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系需要的资料。

器件的识别

- ⑤ 器件类型。
- ⑥ 典型结构和应用资料。

如果设计的器件是多用途的，应在详细规范中说明。这些用途对器件所要求的特性和检验都应得到满足。

如果器件属静电敏感型，应在详细规范中注明。

- ⑦ 外形图和（或）与外形有关的参考文件。
- ⑧ 质量评定类别。
- ⑨ 能在各类器件之间进行比较的最重要的性能参考数据。

〔本规范中，中括号所列内容仅供指导编制详细规范用，不必在详细规范中列出〕。

本规范中，“×”表示当特性或额定值适用时应在详细规范中填写的值。

(×)：表示适用处要给出的数值。